

MIRDC-104-A20U

觸控面板曲面貼合 設備發展動向

作者：盧素涵

執行單位：金屬中心

中華民國一〇四年十一月

目錄

■ 摘要	1
■ 前言	2
■ 貼合製程技術	2
■ 貼合設備動向	7
■ 結論	9



觸控面板曲面貼合設備發展動向

金屬中心 MII 產業分析師 盧素涵

摘要：

目前主流的電容式多點觸控面板主要有五項製程，包括：濺鍍製程、黃光製程、外層鏡片製程、貼合製程以及檢測製程。其中，觸控面板經過母片玻璃切割、加工與強化等前段製程後，皆須進入後段的貼合製程，該製程良率影響生產成本甚鉅。隨著全球穿戴式裝置、電視、智慧型手機、車載面板等市場終端應用產品持續邁向大型化、曲面化發展，各主要觸控面板供應商也積極與搭配的貼合設備業者進行相關的曲面貼合設備技術合作與開發，以確保高貼合良率與維持成本優勢。

《2015 觸控面板曲面貼合 設備發展動向》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>